



本社：〒160-8366

東京都新宿区西新宿 6 丁目 24 番 1 号
西新宿三井ビルディング

報告書番号：PCN#20120808000B

2012 年 10 月 2 日

お客様各位

日本テキサス・インスツルメンツ株式会社
営業・技術本部 カスタマドキュメント
マネージャ 牧 達郎 (牧)

HPA/PWR SOIC パッケージ 一部製品 Cu(銅)線ボンディングワイヤ変更のご案内

(既報 1127 製品からの対象除外 38 製品及び一部製品ワイヤ径変更の連絡)

(第二版 PCN20120808000A 2012 年 9 月 7 日発行, 初版 PCN20120808000 2012 年 8 月 24 日発行)

拝啓 貴社益々ご清栄の事とお喜び申し上げます。平素は弊社製品のご愛顧を賜り、厚く御礼申し上げます。さて、標題の件につきましてご連絡させていただきます。ご査収の程、宜しくお願い申し上げます。

今回のお知らせは、変更実施についての追加連絡になります。変更の詳細は、次頁以降をご参照下さい。

お客様におかれましては、本通知発行日後、**30 日以内**に通知確認のご連絡をお願いいたします。また、30 日以内にご連絡が無い場合には、本変更をご承認いただけたものと判断させていただきます。変更品評価用サンプルもしくは追加データご入用の場合には、本通知発行日後 30 日以内にご依頼をお願いいたします。

変更品の出荷につきましては、お客様との早期変更実施の個別契約を締結している場合を除いては、本通知発行日より **90 日**以降に予定いたしております。この通知期間は、弊社品質標準に基づいております。

本通知は、いかなる製品の製造終了に関する状況を変更するものではありません。既に製造終了の連絡をさせていただいている場合には、本通知によって、既通知の最終受注日及び最終出荷日が延長されることはありません。

本通知は、通知日前 24 ヶ月以内に本変更対象製品をご購入いただいたお客様に連絡させていただいております。

尚、変更時期につきましては、在庫状況により異なりますので、担当営業にお問い合わせ下さい。また、ご不明な点、ご質問等がございましたら、担当営業或いは pcn_tij@list.ti.com にお問い合わせ下さい。

以上

変更概要

通知タイプ	☐ Initial notice (Plan)		☒ Final notice	
変更概要	Design/Specification	☐ Design	☐ Electrical	☐ Mechanical
	Wafer Fab	☐ Site	☐ Process	☐ Material
	Wafer Bump	☐ Site	☐ Process	☐ Material
	☒ Assembly	☐ Site	☐ Process	☒ Material
	Test	☐ Site	☐ Process	
	Others	☐ Packing/Shipping/Labeling	☐ -	
変更内容	下記変更について既報 1127 製品からの対象除外 38 製品及び一部製品ワイヤ径変更の連絡になります。 HPA/PWR SOIC パッケージ 一部製品 Cu(銅)線ボンディングワイア変更 現行 : Au(金)線 変更後 : Cu(銅)線			
対象製品	対象製品リスト参照			
変更時期	12 月上旬の出荷より予定しています。			
品質認定試験	☒ 計画		☐ 終了	
製品表示	☒ 変更無し		☐ 変更あり	
備考	—			

変更内容

内容：今回のお知らせは、下記変更について既報 1127 製品からの対象除外 38 製品及び一部製品ワイヤ径変更の連絡になります。対象除外 38 製品及び製品リスト, TPS2058AD 製品信頼性試験へワイヤ径 1.98mils を追記更新しました。下記を参照ください。

弊社 HPA(ハイパフォーマンスアナログ)/PWR(パワーマネジメント) SOIC パッケージ 一部製品について、現行 Au(金)線ボンディングワイアを使用して製造していますが、機械/電気的特性の向上、同種製品の組立技術推移対応及び供給能力/部材調達利便性向上の為に、Cu(銅)線ボンディングワイアに変更します。その他部材の変更は下記の通りです。尚、今回の変更で、製品についての互換性(寸法/公差), 外観, 動作特性, 品質, 信頼性への影響はありません。

変更内容

ボンディングワイア

現行

Au(金)線

変更後

Cu(銅)線

	現行 (Au 線)	変更後 (Cu 線)
モールド樹脂	4205694	4211880
ワイヤ径 (Mils)	0.8, 0.9, 0.96, 1.0, 1.15, 1.3	0.96, 1.98

理由：機械/電気的特性の向上, 同種製品の組立技術推移対応及び供給能力/部材調達利便性向上の為

対象製品リスト

対象製品名				
☐ :既報対象品(変更後 0.96mils)		☒ :既報対象品(変更後 1.98mils)		取消線:対象除外品
ADS7817U	SN65MLVD047DG4	THS4504DG4	TLC4545IDG4	TLV5606CDRG4
ADS7817U/2K5	SN65MLVD047DR	THS4504DR	TLC4545IDR	TLV5606ID
ADS7817U/2K5G4	SN65MLVD047DRG4	THS4504DRG4	TLC4545IDRG4	TLV5606IDG4
ADS7817UG4	SN75LBC173D	THS4505D	TLC548ID	TLV5606IDR
CDC328AD	SN75LBC173DG4	THS4505DG4	TLC548IDG4	TLV5606IDRG4
CDC328ADG4	SN75LBC173DR	THS4505DR	TLC548IDR	TLV5614ID
CDC328ADR	SN75LBC173DRG4	THS4505DRG4	TLC548IDRG4	TLV5614IDG4
CDC328ADRG4	SN75LBC175D	THS4601CD	TLC551CD	TLV5614IDR
CDC329AD	SN75LBC175DG4	THS4601CDG4	TLC551CDG4	TLV5614IDRG4
CDC329ADG4	SN75LBC175DR	THS4601ID	TLC552CD	TLV5616CD
CDC329ADR	SN75LBC175DRG4	THS4601IDG4	TLC552CDG4	TLV5616CDG4

日本テキサス・インスツルメンツ株式会社

CDC329ADRG4	SN75LBC176D	THS4631D	TLC552CDR	TLV5616CDR
CDCVF2505D	SN75LBC176DG4	THS4631DE4	TLC552CDRG4	TLV5616CDRG4
CDCVF2505DG4	SN75LBC176DR	THS4631DR	TLC555CD	TLV5616ID
CDCVF2505DR	SN75LBC176DRG4	THS4631DRE4	TLC555CDG4	TLV5616IDG4
CDCVF2505DRG4	SN75LBC182D	TL3016CD	TLC555ID	TLV5616IDR
CDCVF25081D	SN75LBC182DG4	TL3016CDG4	TLC555IDG4	TLV5616IDRG4
CDCVF25081DG4	SN75LBC182DR	TL3016CDR	TLC555IDR	TLV5617ACD
CDCVF25081DR	SN75LBC182DRG4	TL3016CDRG4	TLC555IDRG4	TLV5617ACDG4
CDCVF25081DRG4	SN75LVDS390D	TL3016ID	TLC556CD	TLV5617ACDR
INA270AID	SN75LVDS390DG4	TL3016IDG4	TLC556CDG4	TLV5617ACDRG4
INA270AIDG4	SN75LVDS390DR	TL3016IDR	TLC556CDR	TLV5617AID
INA270AIDR	SN75LVDS390DRG4	TL3016IDRG4	TLC556CDRG4	TLV5617AIDG4
INA270AIDRG4	SN75LVDS391D	TL3116ID	TLC556ID	TLV5617AIDR
INA271AID	SN75LVDS391DG4	TL3116IDG4	TLC556IDG4	TLV5617AIDRG4
INA271AIDG4	SN75LVDS391DR	TL3116IDR	TLC556IDR	TLV5618ACD
INA271AIDR	SN75LVDS391DRG4	TL3116IDRG4	TLC556IDRG4	TLV5618ACDG4
INA271AIDRG4	SN75LVDT390D	TLC074AID	TLC5615CD	TLV5618ACDR
OPA1632D	SN75LVDT390DG4	TLC074AIDG4	TLC5615CDG4	TLV5618ACDRG4
OPA1632DG4	SN75LVDT390DR	TLC074AIDR	TLC5615CDR	TLV5618AID
OPA1632DR	SN75LVDT390DRG4	TLC074AIDRG4	TLC5615CDRG4	TLV5618AIDG4
OPA1632DRG4	TB5D2HD	TLC074ID	TLC5620CD	TLV5618AIDR
SN104804D	TB5D2HDE4	TLC074IDG4	TLC5620CDG4	TLV5618AIDRG4
SN104804DE4	TB5D2HDR	TLC074IDR	TLC5620CDR	TLV5620CD
SN104804DR	TB5D2HDRE4	TLC074IDRG4	TLC5620CDRG4	TLV5620CDG4
SN104804DRG4	TB5R1D	TLC0831CD	TLC5620ID	TLV5620CDR
SN104806DR	TB5R1DE4	TLC0831CDG4	TLC5620IDG4	TLV5620CDRG4
SN104806DRG4	TB5R1DR	TLC0831CDR	TLC5620IDR	TLV5620ID
SN10501D	TB5R1DRE4	TLC0831CDRG4	TLC5620IDRG4	TLV5620IDG4
SN10501DG4	TB5T1D	TLC0831ID	TLC7524CD	TLV5620IDR
SN10501DR	TB5T1DE4	TLC0831IDG4	TLC7524CDG4	TLV5620IDRG4
SN10501DRG4	THS3001CD	TLC0831IDR	TLC7524CDR	TLV5623CD
SN10502D	THS3001CDG4	TLC0831IDRG4	TLC7524CDRG4	TLV5623CDG4
SN10502DG4	THS3001CDR	TLC0832CD	TLC7524ID	TLV5623CDR
SN10502DR	THS3001CDRG4	TLC0832CDG4	TLC7524IDG4	TLV5623CDRG4
SN10502DRG4	THS3001ID	TLC0832CDR	TLC7524IDR	TLV5623ID
SN10503D	THS3001IDG4	TLC0832CDRG4	TLC7524IDRG4	TLV5623IDG4
SN10503DG4	THS3001IDR	TLC0834CD	TLC7701ID	TLV5623IDR
SN10503DR	THS3001IDRG4	TLC0834CDG4	TLC7701IDG4	TLV5623IDRG4
SN10503DRG4	THS3061D	TLC0834CDR	TLC7701IDR	TLV5624ID
SN65CML100D	THS3061DG4	TLC0834CDRG4	TLC7701IDRG4	TLV5624IDG4
SN65CML100DG4	THS3061DR	TLC0834ID	TLC7701QD	TLV5624IDR
SN65CML100DR	THS3061DRG4	TLC0834IDG4	TLC7701QDG4	TLV5624IDRG4
SN65CML100DRG4	THS3062D	TLC0834IDR	TLC7701QDR	TLV5625CD
SN65HVD1040D	THS3062DG4	TLC0834IDRG4	TLC7701QDRG4	TLV5625CDG4
SN65HVD1040DG4	THS3091D	TLC1078CD	TLC7703ID	TLV5625CDR
SN65HVD1040DR	THS3091DG4	TLC1078CDG4	TLC7703IDG4	TLV5625CDRG4
SN65HVD1040DRG4	THS3091DR	TLC1078CDR	TLC7703IDR	TLV5625ID
SN65HVD1050D	THS3091DRG4	TLC1078CDRG4	TLC7703IDRG4	TLV5625IDG4
SN65HVD1050DG4	THS3092D	TLC1078ID	TLC7705ID	TLV5625IDR
SN65HVD1050DR	THS3092DG4	TLC1078IDG4	TLC7705IDG4	TLV5625IDRG4
SN65HVD1050DRG4	THS3110ID	TLC1078IDR	TLC7705IDR	TLV5626CD
SN65HVD33D	THS3110IDG4	TLC1078IDRG4	TLC7705IDRG4	TLV5626CDG4
SN65HVD33DG4	THS3110IDR	TLC1079CD	TLC7705QD	TLV5626CDR
SN65HVD33DR	THS3110IDRG4	TLC1079CDG4	TLC7705QDG4	TLV5626CDRG4
SN65HVD33DRG4	THS3111ID	TLC1079CDR	TLC7705QDR	TLV5626ID
SN65HVD34D	THS3111IDG4	TLC1079CDRG4	TLC7705QDRG4	TLV5626IDG4
SN65HVD34DG4	THS3111IDR	TLC14CD	TLC7725ID	TLV5626IDR

日本テキサス・インスツルメンツ株式会社

SN65HVD34DR	THS3111IDRG4	TLC14CDG4	TLC7725IDG4	TLV5626IDRG4
SN65HVD34DRG4	THS3120ID	TLC14CDR	TLC7725IDR	TLV5627CD
SN65HVD35D	THS3120IDG4	TLC14CDRG4	TLC7725IDRG4	TLV5627CDG4
SN65HVD35DG4	THS3121CD	TLC1549CD	TLC7725QD	TLV5627CDR
SN65HVD35DR	THS3121CDG4	TLC1549CDG4	TLC7725QDG4	TLV5627CDRG4
SN65HVD35DRG4	THS3121CDR	TLC1549CDR	TLC7725QDR	TLV5636CD
SN65HVD53D	THS3121CDRG4	TLC1549CDRG4	TLC7725QDRG4	TLV5636CDG4
SN65HVD53DG4	THS3122CD	TLC2201ACD	TLC7733ID	TLV5636CDR
SN65HVD53DR	THS3122CDG4	TLC2201ACDG4	TLC7733IDG4	TLV5636CDRG4
SN65HVD53DRG4	THS3122CDR	TLC2201ACDR	TLC7733IDR	TLV5636ID
SN65HVD54D	THS3122CDRG4	TLC2201ACDRG4	TLC7733IDRG4	TLV5636IDG4
SN65HVD54DG4	THS3122ID	TLC2201AID	TLC7733QD	TLV5636IDR
SN65HVD54DR	THS3122IDG4	TLC2201AIDG4	TLC7733QDG4	TLV5636IDRG4
SN65HVD54DRG4	THS3201D	TLC2201AIDR	TLC7733QDR	TLV5637CD
SN65HVD55D	THS3201DG4	TLC2201AIDRG4	TLC7733QDRG4	TLV5637CDG4
SN65HVD55DG4	THS3201DR	TLC2201CD	TLE2064AID	TLV5637CDR
SN65HVD55DR	THS3201DRG4	TLC2201CDG4	TLE2064AIDG4	TLV5637CDRG4
SN65HVD55DRG4	THS3202D	TLC2201CDR	TLE2064AIDR	TLV5637ID
SN65LBC173D	THS3202DG4	TLC2201CDRG4	TLE2064AIDRG4	TLV5637IDG4
SN65LBC173DG4	THS4001CD	TLC2201ID	TLE2064CD	TLV5637IDR
SN65LBC175D	THS4001CDG4	TLC2201IDG4	TLE2064CDG4	TLV5637IDRG4
SN65LBC175DG4	THS4001CDR	TLC2201IDR	TLE2064CDR	TLV5638CD
SN65LBC175DR	THS4001CDRG4	TLC2201IDRG4	TLE2064CDRG4	TLV5638CDG4
SN65LBC175DRG4	THS4001ID	TLC2202ACD	TLE2425CD	TLV5638CDR
SN65LBC176D	THS4001IDG4	TLC2202ACDG4	TLE2425CDG4	TLV5638CDRG4
SN65LBC176DG4	THS4001IDR	TLC2202ACDR	TLE2425CDR	TMP124AID
SN65LBC176DR	THS4001IDRG4	TLC2202ACDRG4	TLE2425CDRG4	TMP124AIDG4
SN65LBC176DRG4	THS4011CD	TLC2202CD	TLE2425ID	TMP124AIDR
SN65LBC182D	THS4011CDG4	TLC2202CDG4	TLE2425IDG4	TMP124AIDRG4
SN65LBC182DG4	THS4011CDR	TLC2202CDR	TLE2425IDR	TPPM0115D
SN65LBC182DR	THS4011CDRG4	TLC2202CDRG4	TLE2425IDRG4	TPPM0115DG4
SN65LBC182DRG4	THS4011ID	TLC2555ID	TLE2426CD	TPPM0115DR
SN65LVCP22D	THS4011IDG4	TLC2555IDG4	TLE2426CDG4	TPPM0115DRG4
SN65LVCP22DG4	THS4012CD	TLC2652C-8D	TLE2426CDR	TPS1101D
SN65LVCP22DR	THS4012CDG4	TLC2652C-8DG4	TLE2426CDRG4	TPS1101DG4
SN65LVCP22DRG4	THS4012CDR	TLC2652C-8DR	TLV0831CD	TPS1101DR
SN65LVCP23D	THS4012CDRG4	TLC2652C-8DRG4	TLV0831CDG4	TPS1101DRG4
SN65LVCP23DG4	THS4012ID	TLC272BCD	TLV0831CDR	TPS2011D
SN65LVCP23DR	THS4012IDG4	TLC272BCDG4	TLV0831CDRG4	TPS2011DG4
SN65LVCP23DRG4	THS4021ID	TLC272BCDR	TLV0831ID	TPS2011DR
SN65LVDM050D	THS4021IDG4	TLC272BCDRG4	TLV0831IDG4	TPS2011DRG4
SN65LVDM050DG4	THS4021IDR	TLC272BID	TLV0831IDR	TPS2013D
SN65LVDM050DR	THS4021IDRG4	TLC272BIDG4	TLV0831IDRG4	TPS2013DG4
SN65LVDM050DRG4	THS4022ID	TLC272BIDR	TLV0832CD	TPS2013DR
SN65LVDM051D	THS4022IDG4	TLC272BIDRG4	TLV0832CDG4	TPS2013DRG4
SN65LVDM051DG4	THS4031CD	TLC274AID	TLV0832CDR	TPS2043D
SN65LVDM051DR	THS4031CDG4	TLC274AIDG4	TLV0832CDRG4	TPS2043DG4
SN65LVDM051DRG4	THS4031CDR	TLC274AIDR	TLV0832ID	TPS2043DR
SN65LVDM176D	THS4031CDRG4	TLC274AIDRG4	TLV0832IDG4	TPS2043DRG4
SN65LVDM176DG4	THS4031ID	TLC274BID	TLV0832IDR	TPS2048AD
SN65LVDM176DR	THS4031IDG4	TLC274BIDG4	TLV0832IDRG4	TPS2048ADG4
SN65LVDM176DRG4	THS4031IDR	TLC274BIDR	TLV1572CD	TPS2048ADR
SN65LVDM179D	THS4031IDRG4	TLC274BIDRG4	TLV1572CDG4	TPS2048ADRG4
SN65LVDM179DG4	THS4032CD	TLC274CD	TLV1572CDR	TPS2056AD
SN65LVDM179DR	THS4032CDG4	TLC274CDG4	TLV1572CDRG4	TPS2056ADG4
SN65LVDM179DRG4	THS4032CDR	TLC274CDR	TLV1572ID	TPS2056ADR
SN65LVDM180D	THS4032CDRG4	TLC274CDRG4	TLV1572IDG4	TPS2056ADRG4

日本テキサス・インスツルメンツ株式会社

SN65LVDM180DG4	THS4032ID	TLC274ID	TLV1572IDR	TPS2056D
SN65LVDM180DR	THS4032IDG4	TLC274IDG4	TLV1572IDRG4	TPS2056DG4
SN65LVDM180DRG4	THS4032IDR	TLC274IDR	TLV2254ID	TPS2067D
SN65LVDM31D	THS4032IDRG4	TLC274IDRG4	TLV2254IDG4	TPS2067DG4
SN65LVDM31DG4	THS4042CD	TLC277ID	TLV2254IDR	TPS2067DR
SN65LVDM31DR	THS4042CDG4	TLC277IDG4	TLV2254IDRG4	TPS2067DRG4
SN65LVDM31DRG4	THS4051CD	TLC277IDR	TLV2341ID	TPS2080D
SN65LVDS047D	THS4051CDG4	TLC277IDRG4	TLV2341IDG4	TPS2080DG4
SN65LVDS047DG4	THS4051CDR	TLC279ID	TLV2341IDR	TPS2080DR
SN65LVDS047DR	THS4051CDRG4	TLC279IDG4	TLV2341IDRG4	TPS2080DRG4
SN65LVDS047DRG4	THS4051ID	TLC279IDR	TLV2342ID	TPS2081D
SN65LVDS048AD	THS4051IDG4	TLC279IDRG4	TLV2342IDG4	TPS2081DG4
SN65LVDS048ADG4	THS4051IDR	TLC27L2BID	TLV2342IDR	TPS2082D
SN65LVDS048ADR	THS4051IDRG4	TLC27L2BIDG4	TLV2342IDRG4	TPS2082DG4
SN65LVDS048ADRG4	THS4052CD	TLC27L2BIDR	TLV2352ID	TPS2082DR
SN65LVDS051D	THS4052CDG4	TLC27L2BIDRG4	TLV2352IDG4	TPS2082DRG4
SN65LVDS051DG4	THS4052CDR	TLC27L2CD	TLV2352IDR	TPS2087D
SN65LVDS051DR	THS4052CDRG4	TLC27L2CDG4	TLV2352IDRG4	TPS2087DG4
SN65LVDS051DRG4	THS4052ID	TLC27L2CDR	TLV2422ID	TPS2087DR
SN65LVDS100D	THS4052IDG4	TLC27L2CDRG4	TLV2422IDG4	TPS2087DRG4
SN65LVDS100DG4	THS4052IDR	TLC27L2ID	TLV2422IDR	TPS2090D
SN65LVDS100DR	THS4052IDRG4	TLC27L2IDG4	TLV2422IDRG4	TPS2090DG4
SN65LVDS100DRG4	THS4061CD	TLC27L2IDR	TLV2432AID	TPS2090DR
SN65LVDS101D	THS4061CDG4	TLC27L2IDRG4	TLV2432AIDG4	TPS2090DRG4
SN65LVDS101DG4	THS4061CDR	TLC27L4AID	TLV2432AIDR	TPS2092D
SN65LVDS101DR	THS4061CDRG4	TLC27L4AIDG4	TLV2432AIDRG4	TPS2092DG4
SN65LVDS101DRG4	THS4061ID	TLC27L4AIDR	TLV2432CD	TPS2092DR
SN65LVDS104D	THS4061IDG4	TLC27L4AIDRG4	TLV2432CDG4	TPS2092DRG4
SN65LVDS104DG4	THS4061IDR	TLC27L4BID	TLV2432CDR	TPS2375D
SN65LVDS104DR	THS4061IDRG4	TLC27L4BIDG4	TLV2432CDRG4	TPS2375DG4
SN65LVDS104DRG4	THS4062CD	TLC27L4BIDR	TLV2432ID	TPS2375DR
SN65LVDS105D	THS4062CDG4	TLC27L4BIDRG4	TLV2432IDG4	TPS2375DRG4
SN65LVDS105DG4	THS4062CDR	TLC27L4CD	TLV2432IDR	TPS2376D
SN65LVDS105DR	THS4062CDRG4	TLC27L4CDG4	TLV2432IDRG4	TPS2376DG4
SN65LVDS105DRG4	THS4062ID	TLC27L4CDR	TLV2442AID	TPS2376DR
SN65LVDS122D	THS4062IDG4	TLC27L4CDRG4	TLV2442AIDG4	TPS2376DRG4
SN65LVDS122DG4	THS4062IDR	TLC27L7CD	TLV2442AIDR	TPS2811D
SN65LVDS122DR	THS4062IDRG4	TLC27L7CDG4	TLV2442AIDRG4	TPS2811DG4
SN65LVDS122DRG4	THS4081ID	TLC27L7CDR	TLV2442CD	TPS2811DR
SN65LVDS179D	THS4081IDG4	TLC27L7CDRG4	TLV2442CDG4	TPS2811DRG4
SN65LVDS179DG4	THS4082CD	TLC27L7ID	TLV2442CDR	TPS6734ID
SN65LVDS179DR	THS4082CDG4	TLC27L7IDG4	TLV2442CDRG4	TPS6734IDG4
SN65LVDS179DRG4	THS4082CDR	TLC27L7IDR	TLV2442ID	TPS6734IDR
SN65LVDS180D	THS4082CDRG4	TLC27L7IDRG4	TLV2442IDG4	TPS6734IDRG4
SN65LVDS180DG4	THS4082ID	TLC27M4CD	TLV2442IDR	TPS6735ID
SN65LVDS180DR	THS4082IDG4	TLC27M4CDG4	TLV2442IDRG4	TPS6735IDG4
SN65LVDS180DRG4	THS4082IDR	TLC27M4CDR	TLV2444AID	TPS6735IDR
SN65LVDS3486D	THS4082IDRG4	TLC27M4CDRG4	TLV2444AIDG4	TPS6735IDRG4
SN65LVDS3486DG4	THS4130CD	TLC27M7CD	TLV2444CD	TPS6755ID
SN65LVDS3486DR	THS4130CDG4	TLC27M7CDG4	TLV2444CDG4	TPS6755IDG4
SN65LVDS3486DRG4	THS4130ID	TLC27M7CDR	TLV2444CDR	TPS6755IDR
SN65LVDS3487D	THS4130IDG4	TLC27M7CDRG4	TLV2444CDRG4	TPS6755IDRG4
SN65LVDS3487DG4	THS4130IDR	TLC339CD	TLV2444ID	TPS7101QD
SN65LVDS3487DR	THS4130IDRG4	TLC339CDG4	TLV2444IDG4	TPS7101QDG4
SN65LVDS3487DRG4	THS4131CD	TLC339CDR	TLV2444IDR	TPS7101QDR
SN65LVDS34D	THS4131CDG4	TLC339CDRG4	TLV2444IDRG4	TPS7101QDRG4
SN65LVDS34DG4	THS4131CDR	TLC3541ID	TLV2454AID	TPS71025D

日本テキサス・インスツルメンツ株式会社

SN65LVDS34DR	THS4131CDRG4	TLC3541IDG4	TLV2454AIDG4	TPS71025DG4
SN65LVDS34DRG4	THS4131ID	TLC3541IDR	TLV2454AIDR	TPS71025DR
SN65LVDS391D	THS4131IDG4	TLC3541IDRG4	TLV2454AIDRG4	TPS71025DRG4
SN65LVDS391DG4	THS4131IDR	TLC3545ID	TLV2454CD	TPS7133QD
SN65LVDS391DR	THS4131IDRG4	TLC3545IDG4	TLV2454CDG4	TPS7133QDG4
SN65LVDS391DRG4	THS4150CD	TLC3545IDR	TLV2465CD	TPS7133QDR
SN65LVDS9637BD	THS4150CDG4	TLC3545IDRG4	TLV2465CDG4	TPS7133QDRG4
SN65LVDS9637BDG4	THS4150CDR	TLC3702CD	TLV2465CDR	TPS7148QD
SN65LVDS9637BDR	THS4150CDRG4	TLC3702CDG4	TLV2465CDRG4	TPS7148QDG4
SN65LVDS9637BDRG4	THS4215D	TLC3702CDR	TLV2475AIDR	TPS7148QDR
SN65LVDS9637D	THS4215DG4	TLC3702CDRG4	TLV2475AIDRG4	TPS7148QDRG4
SN65LVDS9637DG4	THS4215DR	TLC372CD	TLV2541ID	TPS7201QD
SN65LVDS9637DR	THS4215DRG4	TLC372CDG4	TLV2541IDG4	TPS7201QDG4
SN65LVDS9637DRG4	THS4221D	TLC372CDR	TLV2541IDR	TPS7201QDR
SN65LVDS9638D	THS4221DG4	TLC372CDRG4	TLV2541IDRG4	TPS7201QDRG4
SN65LVDS9638DG4	THS4222D	TLC372ID	TLV2544CD	TPS7233QD
SN65LVDS9638DR	THS4222DG4	TLC372IDG4	TLV2544CDG4	TPS7233QDG4
SN65LVDS9638DRG4	THS4222DR	TLC372IDR	TLV2544CDR	TPS7233QDR
SN65LVDT100D	THS4222DRG4	TLC372IDRG4	TLV2544CDRG4	TPS7233QDRG4
SN65LVDT100DG4	THS4271D	TLC374ID	TLV2772AID	TPS7301QD
SN65LVDT100DR	THS4271DG4	TLC374IDG4	TLV2772AIDG4	TPS7301QDG4
SN65LVDT100DRG4	THS4271DR	TLC374IDR	TLV2772AIDR	TPS7301QDR
SN65LVDT32BD	THS4271DRG4	TLC374IDRG4	TLV2772AIDRG4	TPS7301QDRG4
SN65LVDT32BDG4	THS4281D	TLC393ID	TLV2772CD	TPS7330QD
SN65LVDT32BDR	THS4281DG4	TLC393IDG4	TLV2772CDG4	TPS7330QDG4
SN65LVDT32BDRG4	THS4281DR	TLC393IDR	TLV2772CDR	TPS7330QDR
SN65LVDT33D	THS4281DRG4	TLC393IDRG4	TLV2772CDRG4	TPS7330QDRG4
SN65LVDT33DG4	THS4304D	TLC4501AID	TLV2772ID	TPS7333QD
SN65LVDT33DR	THS4304DG4	TLC4501AIDG4	TLV2772IDG4	TPS7333QDG4
SN65LVDT33DRG4	THS4304DR	TLC4501AIDR	TLV2772IDR	TPS7333QDR
SN65LVDT3486BD	THS4304DRG4	TLC4501AIDRG4	TLV2772IDRG4	TPS7333QDRG4
SN65LVDT3486BDG4	THS4501CD	TLC4502ACD	TLV2774CD	TPS7350QD
SN65LVDT3486BDR	THS4501CDG4	TLC4502ACDG4	TLV2774CDG4	TPS7350QDG4
SN65LVDT34D	THS4502CD	TLC4502ACDR	TLV2774CDR	TPS7350QDR
SN65LVDT34DG4	THS4502CDG4	TLC4502ACDRG4	TLV2774CDRG4	TPS7350QDRG4
SN65LVDT34DR	THS4502ID	TLC4502AID	TLV5604CD	TPS7418D
SN65LVDT34DRG4	THS4502IDG4	TLC4502AIDG4	TLV5604CDG4	TPS7418DG4
SN65LVDT390D	THS4502IDR	TLC4502AIDR	TLV5604CDR	TPS7433D
SN65LVDT390DG4	THS4502IDRG4	TLC4502AIDRG4	TLV5604CDRG4	TPS7433DG4
SN65MLVDO47AD	THS4503ID	TLC4502CD	TLV5604ID	TPS7433DR
SN65MLVDO47ADG4	THS4503IDG4	TLC4502CDG4	TLV5604IDG4	TPS7433DRG4
SN65MLVDO47ADR	THS4503IDR	TLC4502CDR	TLV5606CD	
SN65MLVDO47ADRG4	THS4503IDRG4	TLC4502CDRG4	TLV5606CDG4	
SN65MLVDO47D	THS4504D	TLC4545ID	TLV5606CDR	

日本テキサス・インスツルメンツ株式会社

信頼性試験

信頼性試験計画

信頼性試験期間	開始	2012 年 8 月	終了	2012 年 11 月
信頼性試験 - 試料構成詳細				
Qual Device:	CDCVF25081DR	-	-	
Assembly Site:	TI Taiwan	Package/Code/Pins:	SOIC/D/16	
Mount Compound:	4042500	Mold Compound:	4211880	
Bond Wire:	0.96 Mil Dia., Cu	Leadframe (Finish, Base):	NiPdAu, Cu	
MSL:	JEDEC L-1/260C	-	-	
信頼性試験計画				
Reliability Test	Condition / Duration	Sample Size		
		Lot#1	Lot#2	Lot#3
Electrical Characterization	-	30	-	-
**High Temp. Storage Bake	150C, 500, 1000hrs	77	77	77
**Autoclave	121C, 96 Hrs	77	77	77
**T/C	-65C/150C, 500 Cyc	77	77	77
Manufacturability	per mfg. Site specification	per spec	per spec	per spec
Moisture Sensitivity	JEDEC L-1/260C	12	-	-
Notes: ** Preconditioning Sequence: JEDEC L-1/260C				

信頼性試験計画

信頼性試験期間	開始	2012 年 8 月	終了	2012 年 11 月
信頼性試験 - 試料構成詳細				
Qual Device:	SN65HVD1050DR	-	-	
Assembly Site:	TI Taiwan	Package/Code/Pins:	SOIC/D/8	
Mount Compound:	4042500	Mold Compound:	4211880	
Bond Wire:	0.96 Mil Dia., Cu	Leadframe (Finish, Base):	NiPdAu, Cu	
MSL:	JEDEC L-1/260C	-	-	
信頼性試験計画				
Reliability Test	Condition / Duration		Sample Size	
**Autoclave	121C, 96 Hrs		77	
**T/C	-65C/150C, 500 Cyc		77	
Manufacturability	per mfg. Site specification		per spec	
Moisture Sensitivity	JEDEC L-1/260C		12	
Notes: ** Preconditioning Sequence: JEDEC L-1/260C				

信頼性試験計画

信頼性試験期間	開始	2012 年 8 月	終了	2012 年 11 月
信頼性試験 - 試料構成詳細				
Qual Device:	TB3R2DR	-	-	
Assembly Site:	TI Taiwan	Package/Code/Pins:	SOIC/D/16	
Mount Compound:	4042500	Mold Compound:	4211880	
Bond Wire:	0.96 Mil Dia., Cu	Leadframe (Finish, Base):	NiPdAu, Cu	
MSL:	JEDEC L-2/260C	-	-	
信頼性試験計画				
Reliability Test	Condition / Duration	Sample Size		
		Lot#1	Lot#2	Lot#3
**High Temp. Storage Bake	150C, 500, 1000hrs	77	77	77
**Autoclave	121C, 96 Hrs	77	77	77
**T/C	-65C/150C, 500 Cyc	77	77	77
Manufacturability	per mfg. Site specification	per spec	per spec	per spec
Moisture Sensitivity	JEDEC L-2/260C	12	-	-
Notes: ** Preconditioning Sequence: JEDEC L-2/260C				

信頼性試験計画				
信頼性試験期間	開始	2012 年 8 月	終了	2012 年 11 月
信頼性試験 - 試料構成詳細				
Qual Device:	TLC3702CDR	-	-	
Assembly Site:	TI Taiwan	Package/Code/Pins:	SOIC/D/8	
Mount Compound:	4042500	Mold Compound:	4211880	
Bond Wire:	0.96 Mil Dia., Cu	Leadframe (Finish, Base):	NiPdAu, Cu	
MSL:	JEDEC L-1/260C	-	-	
信頼性試験計画				
Reliability Test	Condition / Duration	Sample Size		
		Lot#1	Lot#2	Lot#3
**High Temp. Storage Bake	150C, 500, 1000hrs	77	77	77
**Autoclave	121C, 96 Hrs	77	77	77
**T/C	-65C/150C, 500 Cyc	77	77	77
Manufacturability	per mfg. Site specification	per spec	per spec	per spec
Moisture Sensitivity	JEDEC L-1/260C	12	-	-
Notes: ** Preconditioning Sequence: JEDEC L-1/260C				

信頼性試験計画				
信頼性試験期間	開始	2012 年 8 月	終了	2012 年 11 月
信頼性試験 - 試料構成詳細				
Qual Device:	TPS2058AD	-	-	
Assembly Site:	TI Taiwan	Package/Code/Pins:	SOIC/D/16	
Mount Compound:	4042500	Mold Compound:	4211880	
Bond Wire:	1.98 Mil Dia., Cu	Leadframe (Finish, Base):	NiPdAu, Cu	
MSL:	JEDEC L-1/260C	-	-	
信頼性試験計画				
Reliability Test	Condition / Duration	Sample Size		
		Lot#1	Lot#2	
**Autoclave	121C, 96 Hrs	77	77	
**T/C	-65C/150C, 500 Cyc	77	77	
Manufacturability	per mfg. Site specification	per spec	per spec	
Moisture Sensitivity	JEDEC L-1/260C	12	-	
Notes: ** Preconditioning Sequence: JEDEC L-1/260C				

信頼性試験計画				
信頼性試験期間	開始	2012 年 8 月	終了	2012 年 11 月
信頼性試験 - 試料構成詳細				
Qual Device:	MAX232DR	-	-	
Assembly Site:	TI Malaysia	Package/Code/Pins:	SOIC/D/16	
Mount Compound:	4211470	Mold Compound:	4211880	
Bond Wire:	0.96 Mil Dia., Cu	Leadframe (Finish, Base):	NiPdAu, Cu	
MSL:	JEDEC L-1/260C	-	-	
信頼性試験計画				
Reliability Test	Condition / Duration	Sample Size		
		Lot#1	Lot#2	Lot#3
Steady-state Life Test	150C, 168, 300 hrs	77	77	77
Electrical Characterization	-	30	-	-
**High Temp. Storage Bake	170C, 420hrs	77	77	77
**Biased HAST	130C/85%RH, 96 Hrs	77	77	77
**Autoclave	121C, 96 Hrs	77	77	77
**T/C	-65C/150C, 500 Cyc	77	77	77
Flammability	Method A - UL94-0	5	5	5
Flammability	Method B - IEC 695-2-2	5	5	5
Flammability	Method C - UL 1694	5	5	5
Manufacturability	per mfg. Site specification	per spec	per spec	per spec
Moisture Sensitivity	JEDEC L-1/260C	12	12	12
Notes: ** Preconditioning Sequence: JEDEC L-1/260C				

信頼性試験計画				
信頼性試験期間	開始	2012 年 8 月	終了	2012 年 11 月
信頼性試験 - 試料構成詳細				
Qual Device:	RC4558DR	-	-	
Assembly Site:	TI Malaysia	Package/Code/Pins:	SOIC/D/8	
Mount Compound:	4211470	Mold Compound:	4211880	
Bond Wire:	0.96 Mil Dia., Cu	Leadframe (Finish, Base):	NiPdAu, Cu	
MSL:	JEDEC L-1/260C	-	-	
信頼性試験計画				
Reliability Test	Condition / Duration	Sample Size		
		Lot#1	Lot#2	Lot#3
Steady-state Life Test	150C, 168, 300 hrs	77	-	-
Electrical Characterization	-	30	-	-
**High Temp. Storage Bake	170C, 420hrs	77	-	-
**Biased HAST	130C/85%RH, 96 Hrs	77	-	-
**Autoclave	121C, 96 Hrs	77	-	-
**T/C	-65C/150C, 500 Cyc	77	77	77
Flammability	Method A - UL94-0	5	-	-
Flammability	Method B - IEC 695-2-2	5	-	-
Flammability	Method C - UL 1694	5	-	-
Manufacturability	per mfg. Site specification	per spec	-	-
Moisture Sensitivity	JEDEC L-1/260C	12	12	12
Notes: ** Preconditioning Sequence: JEDEC L-1/260C				

信頼性試験計画				
信頼性試験期間	開始	2012 年 8 月	終了	2012 年 11 月
信頼性試験 - 試料構成詳細				
Qual Device:	SN74LV14ADR	-	-	
Assembly Site:	TI Malaysia	Package/Code/Pins:	SOIC/D/14	
Mount Compound:	4211470	Mold Compound:	4211880	
Bond Wire:	0.96 Mil Dia., Cu	Leadframe (Finish, Base):	NiPdAu, Cu	
MSL:	JEDEC L-1/260C	-	-	
信頼性試験計画				
Reliability Test	Condition / Duration	Sample Size		
		Lot#1	Lot#2	Lot#3
Steady-state Life Test	150C, 168, 300 hrs	77	-	-
Electrical Characterization	-	30	-	-
**High Temp. Storage Bake	170C, 420hrs	77	-	-
**Biased HAST	130C/85%RH, 96 Hrs	77	-	-
**Autoclave	121C, 96 Hrs	77	-	-
**T/C	-65C/150C, 500 Cyc	77	77	77
Flammability	Method A - UL94-0	5	-	-
Flammability	Method B - IEC 695-2-2	5	-	-
Flammability	Method C - UL 1694	5	-	-
Manufacturability	per mfg. Site specification	per spec	-	-
Moisture Sensitivity	JEDEC L-1/260C	12	12	12
Notes: ** Preconditioning Sequence: JEDEC L-1/260C				

日本テキサス・インスツルメンツ株式会社

信賴性試驗計畫				
信賴性試驗期間	開始	2012 年 8 月	終了	2012 年 11 月
信賴性試驗 - 試料構成詳細				
Qual Device:	ULN2003ADR		-	-
Assembly Site:	TI Malaysia	Package/Code/Pins:	SOIC/D/16	
Mount Compound:	4211470	Mold Compound:	4211880	
Bond Wire:	0.96 Mil Dia., Cu	Leadframe (Finish, Base):	NiPdAu, Cu	
MSL:	JEDEC L-1/260C		-	-
信賴性試驗計畫				
Reliability Test	Condition / Duration		Sample Size	
Steady-state Life Test	150C, 168, 300 hrs		77	
Electrical Characterization	-		30	
**High Temp. Storage Bake	170C, 420hrs		77	
**Biased HAST	130C/85%RH, 96 Hrs		77	
**Autoclave	121C, 96 Hrs		77	
**T/C	-65C/150C, 500 Cyc		77	
Manufacturability	per mfg. Site specification		per spec	
Notes: ** Preconditioning Sequence: JEDEC L-1/260C				

信頼性試験結果				
信頼性試験期間	開始	—	終了	2011 年 10 月 17 日
信頼性試験 - 試料構成詳細				
Qual Device:	CD4053BM96		-	-
Assembly Site:	TI Mexico	Package/Code/Pins:	SOIC/D/16	
Mount Compound:	4147858	Mold Compound:	4211880	
Bond Wire:	0.96 Mil Dia., Cu	Leadframe (Finish, Base):	NiPdAu, Cu	
MSL:	JEDEC L-1/260C		-	-
信頼性試験結果				
Reliability Test	Condition / Duration		Sample Size/ Fails	
Steady-state Life Test	150C, 300 Hrs		77/0	
Electrical Characterization	-		Approved	
**High Temp. Storage Bake	170C, 600 Hrs		77/0	
**Biased HAST	130C/85%RH, 192 Hrs		77/0	
**Autoclave	121C, 96 Hrs		77/0	
**T/C	-65C/150C, 500 Cyc		77/0	
Visual / Mechanical	-		Approved	
Lead Pull	# of leads to destruction, min. 3 units		22/0	
Bond Strength	76 ball bonds, min. 3 units		76/0	
Manufacturability	per mfg. Site specification		Approved	
**Thermal Shock	-65C/150C, 500 Cyc		77/0	
X-ray	Top-side only		5/0	
Moisture Sensitivity	JEDEC L-1/260C		12/0	
Notes: ** Preconditioning Sequence: JEDEC L-1/260C				

信頼性試験結果				
信頼性試験期間	開始	—	終了	2011 年 10 月 17 日
信頼性試験 — 試料構成詳細				
Qual Device:	LM358DR	-	-	
Assembly Site:	TI Mexico	Package/Code/Pins:	SOIC/D/8	
Mount Compound:	4147858	Mold Compound:	4211880	
Bond Wire:	0.96 Mil Dia., Cu	Leadframe (Finish, Base):	NiPdAu, Cu	
MSL:	JEDEC L-1/260C	-	-	
信頼性試験結果				
Reliability Test	Condition / Duration	Sample Size/ Fails		
		Lot#1	Lot#2	Lot#3
Steady-state Life Test	150C, 168, 300 hrs	77/0	-	-
Electrical Characterization	-	Approved	-	-
**High Temp. Storage Bake	170C, 420 Hrs	77/0	-	-
**Biased HAST	130C/85%RH, 192 Hrs	77/0	-	-
**Autoclave	121C, 96 Hrs	77/0	-	-
**T/C	-65C/150C, 500 Cyc	77/0	77/0	77/0
Visual / Mechanical	-	Approved	-	-
Lead Pull	-	22/0	-	-
Bond Strength	76 ball bonds, min. 3 units	76/0	-	-
Manufacturability	per mfg. Site specification	Approved	-	-
**Thermal Shock	-65C/150C, 500 Cyc	77/0	77/0	77/0
X-ray	top side only	5/0	-	-
Moisture Sensitivity	JEDEC L-1/260C	12/0	12/0	12/0
Notes: ** Preconditioning Sequence: JEDEC L-1/260C				

信頼性試験結果				
信頼性試験期間	開始	—	終了	2011 年 10 月 17 日
信頼性試験 — 試料構成詳細				
Qual Device:	TL494IDR	-	-	
Assembly Site:	TI Mexico	Package/Code/Pins:	SOIC/D/16	
Mount Compound:	4147858	Mold Compound:	4211880	
Bond Wire:	0.96 Mil Dia., Cu	Leadframe (Finish, Base):	NiPdAu, Cu	
MSL:	JEDEC L-1/260C	-	-	
信頼性試験結果				
Reliability Test	Condition / Duration	Sample Size/ Fails		
		Lot#1	Lot#2	Lot#3
Steady-state Life Test	150C, 168, 300 hrs	77/0	77/0	77/0
Electrical Characterization	-	Approved	-	-
**High Temp. Storage Bake	170C, 600 Hrs	77/0	77/0	77/0
**Biased HAST	130C/85%RH, 192 Hrs	77/0	77/0	77/0
**Autoclave	121C, 96 Hrs	77/0	77/0	77/0
**T/C	-65C/150C, 500 Cyc	77/0	77/0	77/0
Visual / Mechanical	-	Approved	Approved	Approved
Lead Pull	-	22/0	22/0	22/0
Flammability	Method A - UL94V-0	5/0	5/0	5/0
Flammability	Method B - IEC 695-2-2	5/0	5/0	5/0
Flammability	Method C - UL1694	5/0	5/0	5/0
Bond Strength	76 ball bonds, min. 3 units	76/0	76/0	76/0
Manufacturability	per mfg. Site specification	Approved	Approved	Approved
**Thermal Shock	-65C/150C, 500 Cyc	77/0	77/0	77/0
X-ray	top side only	5/0	5/0	5/0
Moisture Sensitivity	JEDEC L-1/260C	12/0	12/0	12/0
Notes: ** Preconditioning Sequence: JEDEC L-1/260C				

日本テキサス・インスツルメンツ株式会社

信頼性試験結果				
信頼性試験期間	開始	—	終了	2011 年 10 月 17 日
信頼性試験 - 試料構成詳細				
Qual Device:	ULN2003ADR	-	-	
Assembly Site:	TI Mexico	Package/Code/Pins:	SOIC/D/16	
Mount Compound:	4147858	Mold Compound:	4211880	
Bond Wire:	0.96 Mil Dia., Cu	Leadframe (Finish, Base):	NiPdAu, Cu	
MSL:	JEDEC L-1/260C	-	-	
信頼性試験結果				
Reliability Test	Condition / Duration	Sample Size/ Fails		
		Lot#1	Lot#2	Lot#3
Steady-state Life Test	150C, 300 Hrs	77/0	-	-
Electrical Characterization	-	Approved	-	-
**High Temp. Storage Bake	170C, 600 Hrs	77/0	77/0	77/0
**Biased HAST	130C/85%RH, 192 Hrs	77/0	-	-
**Autoclave	121C, 96 Hrs	77/0	77/0	77/0
**T/C	-65C/150C, 500 Cyc	77/0	77/0	77/0
Visual / Mechanical	-	Approved	-	-
Lead Pull	-	22/0	22/0	22/0
Bond Strength	76 ball bonds, min. 3 units	76/0	-	-
Manufacturability	per mfg. Site specification	Approved	-	-
**Thermal Shock	-65C/150C, 500 Cyc	77/0	77/0	77/0
X-ray	Top-side only	5/0	5/0	5/0
Moisture Sensitivity	JEDEC L-1/260C	12/0	12/0	12/0
Notes: ** Preconditioning Sequence: JEDEC L-1/260C				